

46

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: PROSIDING**

Judul karya ilmiah (paper) : Ketebalan Dan Nilai Resistivitas Lapisan Tipis Cu/Ni/Cu/Ni Hasil Penumbuhan Dengan Metode Elektroplating Pada Variasi Tegangan Deposisi (V)

Jumlah Penulis : 3 orang

Nama Penulis : Rizalul Fiqry, Moh. Toifur, Azmi Khusnani

Status Pengusul : Penulis Tunggal/ Penulis pertama/ penulis ke 2 / penulis korespondensi **

Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : Prosiding Seminar Nasional Edusaintek
b. ISBN/ISSN : 978-602-5614-35-4
c. Tahun terbit, tempat pelaksanaan :
d. Penerbit/organizer : FMIPA UNIMUS 2018
e. Alamat Repository PT/web prosiding : <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/index>
f. Terindeks di (jika ada) :



Kategori Publikasi Makalah :
(beri V pada kategori yang tepat)

☐
☐

Prosiding Forum Ilmiah Internasional
Prosiding Forum Ilmiah Nasional


Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		1	1
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	2,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/prosiding (30%)		3	2,5
Total = (100%)		3	3
Nilai Pengusul		10	9
		2	1,8
Komentar Peer Review	<p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : <i>Artikel ini telah lengkap dan sesuai dg format sebuah artikel ilmiah.</i></p> <p>2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : <i>Kedalaman pembahasan cukup dalam dg adanya karakteristik yg dilakukan dalam riset.</i></p>		

	<p>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :</p> <p>Kemutakhiran terus terjadi karena terapan Cu/Ni dalam teknologi sensor.</p> <p>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :</p> <p>Cebuah prosiding yg telah dipersiapkan sudah cukup baik sbg kumpulan karya ilmiah</p> <p>5. Indikasi plagiasi :</p> <p>Saya belum menemukan plagiasi.</p> <p>6. Kesesuaian bidang ilmu :</p> <p>Sesuai dalam bidang Fisik Material.</p>
--	--

2020

Reviewer 1/2 **


 Nama Prof. Answari
 NIP/NIY. 1953051419801103
 Bidang Ilmu Fisika Material
 Jabatan Akademik Guru Besar
 Unit Kerja FMIPA UNY

*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
 ** coret yang tidak perlu

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH: **PROSIDING**

Judul karya ilmiah (paper) : Ketebalan Dan Nilai Resitivitas Lapisan Tipis Cu/Ni/Cu/Ni Hasil Penumbuhan Dengan Metode Elektroplating Pada Variasi Tegangan Deposisi (V)

Jumlah Penulis : 3 orang

Nama Penulis : Rizalul Fiqry, Moh. Toifur, Azmi Khusnani

Status Pengusul : ~~Penulis Tunggal/~~Penulis pertama/penulis ke 2 /~~penulis korespodensi~~ **

Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : Prosiding Seminar Nasional Edusaintek
b. ISBN/ISSN : 978-602-5614-35-4
c. Tahun terbit, tempat pelaksanaan :
d. Penerbit/organizer : FMIPA UNIMUS 2018
e. Alamat Repository PT/web prosiding : <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/index>
f. Terindeks di (jika ada) :

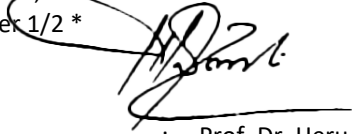
Kategori Publikasi Makalah : ☐ Prosiding Forum Ilmiah Internasional
(beri V pada kategori yang tepat) ☐ Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <div></div>	Nasional <div></div>	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)		1	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3	2,75
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/prosiding (30%)		3	2,5
Total = (100%)		10	9,25
Nilai Pengusul		2	
Nilai Reviewer	Penulis kedua dari tiga penulis = (40%/2) X 9,25 =		1,85
Komentar <i>Peer Review</i>	<div><div>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : Tulisan terdiri atas; Judul, Penulis, Abstrak Kata kunci, Pendahuluan, Kajian literatur, Metode Penelitiann, Hasil Penelitian, Simpulan, Ucapan Terima kasih, Daftar Pustaka</div><div>2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : Tulisan membahas pengaruh variasi teganan deposisi terhadap ketebalan dan resistivitas lapisan tipis Cu/Ni/Cu/Ni. Pembahasan dilakukan dengan mendalam. Pembahasan dilakukan tanpa melibatkan refrensi pembanding.</div><div>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Ada 21 refrensi artikel. Artikel terbaru 2017</div><div>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : Makalah disajikan pada Seminar Nasional Edusaintek 2018, Universitas Muhammadiyah Semarang</div><div>5. Indikasi plagiasi : -</div></div>		

	6. Kesesuaian bidang ilmu : Tulisan berkaitan dengan Fisika, sesuai dengan bidang ilmu penulis
--	--

Yogyakarta, 16 Mei 2020
Reviewer 1/2 *


Nama : Prof. Dr. Heru Kuswanto, M.Si
NIP : 196111121987021001
Bidang Ilmu : Fisika
Jabatan Akademik : Guru Besar
Unit Kerja : FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta